

Title (en)

Method of manufacturing a connection between a plurality of varnish-insulated conductors

Title (de)

Verfahren zur Herstellung einer elektrischen Verbindung zwischen mehreren lackisolierten Leitern

Title (fr)

Procédé pour établir une connection entre plusieurs conducteurs vernis

Publication

EP 1571731 A1 20050907 (DE)

Application

EP 05003715 A 20050222

Priority

DE 102004010723 A 20040305

Abstract (en)

The ends of the wires [1] which are placed in parallel and are inserted in a metal sleeve [2]. The wires are then subjected to a resistance welding process in a compression action. The welding involves a first stage in which the wires are bonded and a second where the wires and sleeve weld together.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer elektrischen Verbindung zwischen mehreren lackisolierten elektrischen Leitern. Erfindungsgemäß werden die nicht abisolierten Enden der Leiter in eine gemeinsame Metallhülse eingeführt, so dass die Leiter parallel zueinander zu liegen kommen. Nachfolgend werden die Leiter mit der Metallhülse mit Hilfe eines elektrischen Widerstandsschweißverfahrens verschweißt.
<IMAGE>

IPC 1-7

H01R 4/02

IPC 8 full level

H01R 43/02 (2006.01); **H01R 4/02** (2006.01); **H02G 1/14** (2006.01)

CPC (source: EP)

H01R 4/026 (2013.01)

Citation (search report)

- [Y] GB 2232013 A 19901128 - SHIN KIN ENTERPRISES CO LTD [TW]
- [Y] WO 9627220 A1 19960906 - ASEA BROWN BOVERI [SE], et al
- [Y] EP 0410211 A1 19910130 - SIEMENS AG [DE]
- [Y] US 4396819 A 19830802 - MUCHKIN VADIM V [SU], et al
- [Y] US 4034152 A 19770705 - WARNER ALLAN S
- [A] EP 0314319 A1 19890503 - HITACHI LTD [JP]

Cited by

CN103394818A

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

EP 1571731 A1 20050907; DE 102004010723 A1 20050922; JP 2005251744 A 20050915

DOCDB simple family (application)

EP 05003715 A 20050222; DE 102004010723 A 20040305; JP 2005045362 A 20050222